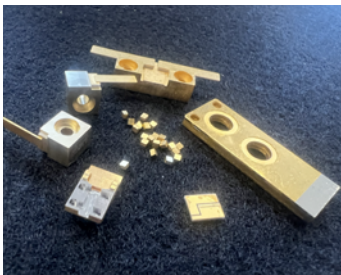


Japanese Microfabrication, Powering Next-Gen Technologies

Using five leading technology, "Cutting", "Grinding", "Polishing", "Metalizing", "Bonding", TECNISCO realizes customer requirements with high QCD quality. We provide one-stop support from prototyping to mass production.

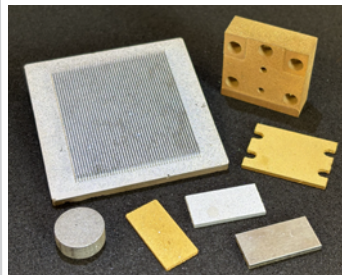
[Products]



Metal Diamond Composites

Original new material featuring ultra-high thermal conductivity over 900 W/m·K and low thermal expansion.

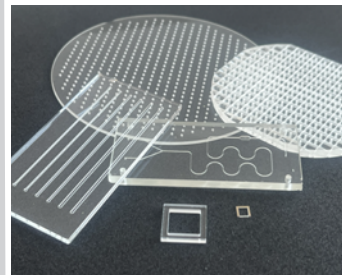
See the detail. →



Heatsink

Heatsinks for optical communication, high-power lasers, and MPUs.

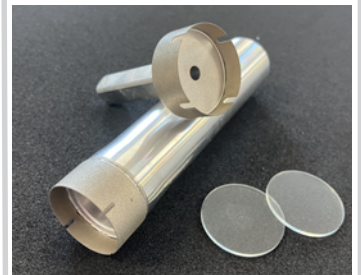
See the detail. →



Precision Processed Glass

Precision glass components enabling microstructures required in the MEMS and medical industry.

See the detail. →



All Blade Core Drill

Constructed entirely with grindstone at the cutting edge, it ensures a long tool life. The extremely thin edge enhances machining precision.

See the detail. →



"Cross-edge®" Technology

"Cross-edge" technology means combined technologies crossing more than two different leading-edge processing technologies to make a product. The technology is based on the following five processing technologies: "Cutting", "Grinding", "Polishing", "Metalizing", and "Bonding".

Through the "Cross-edge" Technology, we can provide the advantages below by undertaking several processes as your one-stop solution partner.

- Optimized processes
- Shorter lead time
- Stabler product quality
- Higher cost performance

We provide products best-suited for your needs to solve challenges.



TECNISCO.LTD.

<https://www.tecnisco.com/>

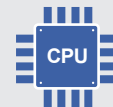
Main Usage



- Laser for industrial use
- Digital equipment
- Factory automation
- Life science



- Semiconductor
- Vehicle-mounted sensor
- AV/Mobile
- Power device



- CPU
- GPU
- AI
- Micro electronics

We are looking for dealers and distributors.



Contact to: ttc@tokyo-kosha.or.jp

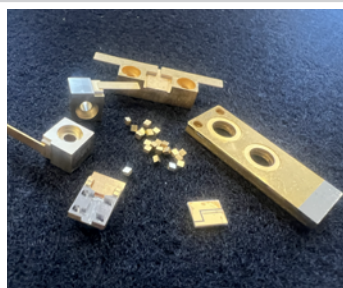
<https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/en/>

Tokyo SME Support Center is founded by Tokyo Metropolitan Government to assist SMEs in Tokyo.

日本の微細加工が、次世代技術を切り拓く

切る・削る・磨く・メタライズ・接合の5つの先端加工技術と多彩な素材、高いQCDを武器に、試作から量産までワンストップ対応で、お客様のご要望を実現。

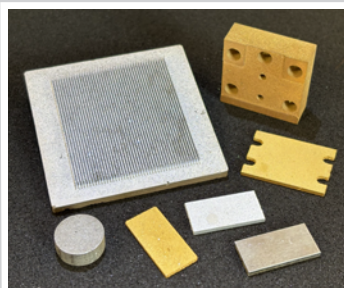
当社製品群



ダイヤモンド複合材

900W/mK以上の高い熱伝導率と低い熱膨張率を実現するオリジナルの新規材料。

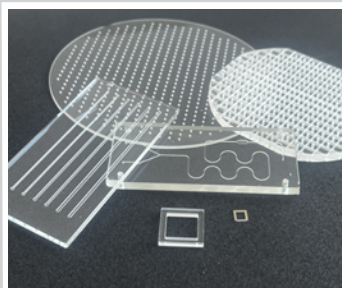
詳しくはこちら



ヒートシンク

光通信・高出力半導体レーザー向け、パワー半導体・MPU向けのヒートシンクを提供。

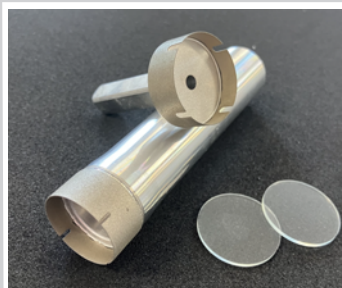
詳しくはこちら



精密加工ガラス

MEMS・医療分野で求められる微細構造を実現する精密ガラス部品。

詳しくはこちら



All Bladeコアドリル

刃先部分を全て砥石で構成し長寿命化を実現。極めて薄い刃先は加工品質向上へ。

詳しくはこちら



クロスエッジ® Technology

クロスエッジ Technology とは、最先端技術をクロスさせるという意味で、「切る」「削る」「磨く」「メタライズ」「接合」の5つの加工技術を中心に、異なる2つ以上の加工を組み合わせるものです。

クロスエッジtechnologyで複数工程をすべて当社で行うことにより以下のメリットをお客様にご提供いたします。

- 工程の最適化
- リードタイムの短縮
- 品質コントロール
- 高いコストパフォーマンス

お客様の課題に最適な工程をご提案し、ご要望にお応えします。



株式会社テクニスコ

<https://www.technisco.com/>

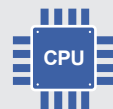
主な用途



- 産業用レーザー
- デジタル機器
- ファクトリーオートメーション
- ライフサイエンス



- 半導体
- 車載センサー
- AV/ モバイル
- パワーデバイス



- CPU
- GPU
- AI
- マイクロエレクトロニクス

代理店・販売代理店を探しています。

2025年9月3日